



DDR4 SDRAM MODULE PART NUMBERING

H M A X XX X X X X X X - XX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SK Hynix MEMORY

PRODUCT FAMILY

M : DRAM MODULE

PRODUCT MODE

A : DDR4 SDRAM

COMPONENT DENSITY

4 : 4Gb
8 : 8Gb
A : 16Gb
B : 32Gb
C : 64Gb

MEMORY DEPTH

51 : 512Mb
1G : 1Gb
2G : 2Gb
4G : 4Gb
8G : 8Gb
AG : 16Gb
BG : 32Gb

MODULE TYPE

U : 288 pin Unbuffered DIMM
S : 260 pin Small Outline DIMM
R : 288 pin Registered DIMM
L : 288 pin Load Reduction DIMM

DATA WIDTH & MODULE HEIGHT

6 : x64/LP 7 : x72/LP
1 : x64/VLP 8 : x72/VLP
2 : x64/ULP 9 : x72/ULP

DIE GENERATION

M : 1st D : 5th
A : 2nd E : 6th
B : 3rd F : 7th
C : 4th G : 8th

SPEED(tCL-tRCD-tRP)

UH : DDR4-2400 17-17-17
UL : DDR4-2400 20-18-18
VK : DDR4-2666 19-19-19
VN : DDR4-2666 22-19-19
WM : DDR4-2933 21-21-21
WR : DDR4-2933 24-21-21
XN : DDR4-3200 22-22-22
XS : DDR4-3200 26-22-22

OPERATING TEMPERATURE & VDD

N : Commercial Temp(0°C ~ 85°C) &
1.2V

ORGANIZATION

4 : x4
8 : x8
6 : x16

PACKAGE MATERIAL

R : Lead Free & Halogen Free
(RoHS Compliant)

PACKAGE TYPE

F : FBGA
J : Flipchip SDP
B : CoC DDP
M : FBGA DDP
P : Flipchip Planar DDP
2 : TSV 2 high stack
4 : TSV 4 high stack